

表 補助金制度の対象分野・品目

対象分野・品目	補助金の性質
A. サブアッセンブリ	売上高連動型補助金
ディスプレイモジュール	
カメラモジュール	
B. ベアコンポーネント	売上高連動型補助金
非表面実装デバイス（NSMD）受動部品	
エレクトロメカニカル	
多層プリント基板（PCB）	
リチウムイオン電池セル（デジタルアプリケーション用。蓄電池や自動車用は除く）	
モバイル、ITハードウェア用のエンクロージャ	
C. 特定ベアコンポーネント	ハイブリッド補助金
HDI、MSAP、フレキシブル基盤（PCB）	
SMD受動部品	
D. サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備	設備投資補助金
上記A～Cに使用される部品	
エレクトロニクス製品生産に使用される資本品	

（出所）インド政府公表資料よりジェトロ作成